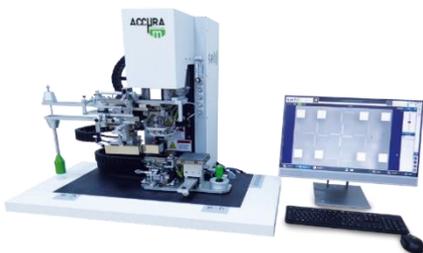


COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Jeoire, le 19 août 2020

LANCEMENT DU PARTENARIAT SET - TAIPRO ENGINEERING **Nouveau centre de démo de flip-chip bonding pour le Benelux**

Fournisseur leader mondial de flip-chip bonders de haute précision, SET démarre sa collaboration avec la société TAIPRO ENGINEERING, basée à Liège, qui produit et commercialise des systèmes micro-électroniques pour la Belgique et l'international. TAIPRO a notamment mis au point le plus petit capteur de pression au monde.

L'objectif de ce partenariat : proposer tests et prestations de flip-chip bonding aux clients du Benelux et conquérir de nouveaux marchés.



Mise à disposition d'une ACCμRA M

Le flip-chip bonding est une technologie d'assemblage de composants, utilisée pour effectuer les connexions électroniques de haute précision et haute densité.

Installée par SET dans la salle blanche de TAIPRO ENGINEERING, la première machine de démonstration proposée est une ACCμRA M. Facile d'utilisation, ce flip-chip bonder est

prisé des centres de recherche et des universités. Il permet d'aligner manuellement et d'assembler des composants avec une précision finale de 3 μm.

TAIPRO à la manœuvre

Basée près de Liège, TAIPRO ENGINEERING assurera elle-même l'assemblage des composants de ses clients, soit sous forme de tests, soit sous forme de prestations (mini-productions). Spécialiste en la matière, l'entreprise belge sera aussi en mesure de recevoir les clients de SET ayant besoin de tous les autres services liés à la micro-fabrication disponible chez TAIPRO (stud bumping, shear test...).

Une ouverture attendue sur le marché européen

Positionné en plein cœur de l'Europe, ce nouveau centre de démo s'adresse directement aux clients du Benelux. « *Il répond à une demande croissante en équipements d'assemblage de composants ultraprecis pour la recherche sur le vieux continent.* », souligne Pascal Metzger, PDG de SET.

« *Il répond également à un besoin, d'une part de miniaturisation de plus en plus importante et d'autre part de mixer les différentes techniques de micro-assemblages permettant d'obtenir des solutions innovantes et robustes pour des environnements très exigeants. C'est une opportunité unique de s'ouvrir à ces nouveaux marchés* », déclare Michel Saint-Mard, Administrateur délégué de TAIPRO ENGINEERING.

SET, SCOP internationale

Avec plusieurs centaines de flip-chip bonders installés dans des salles blanches du monde entier, SET est un leader international reconnu sur son marché. L'entreprise haut-savoyarde, née en 1975, a la particularité d'être une SCOP depuis 2012, suite à une reprise réussie par ses salariés.

Pour plus d'informations

SET (France) : Anne-Sophie Perrin, Communication
Tél. +33 (0)4 50 35 83 92 - aperrin@set-sas.fr
www.set-sas.fr

TAIPRO (Belgique) : Eric Poskin, Corporate Communication
Tél. +32 (0)4 77 20 57 71 - e.poskin@taipro.be
www.taipro.be